

“固体所青联会”第九期学术论坛

报告题目： COMSOL多物理场仿真计算在科研中应用

报告人： 中仿科技 工程师

报告时间： 2013年5月29日下午2:30（周三）

报告地点： 固体所三号楼321会议室

主办单位： 中科院固体物理研究所青年联合会

中科院青年创新促进会合肥物质科学研究院小组

报告内容： COMSOL Multiphysics是一款大型的有限元仿真软件，广泛应用于各个领域的科学研究以及工程分析，被当今世界科学家称为“第一款真正的任意多物理场直接耦合分析软件”。目前，COMSOL的产品架构已经扩充到30多个模块，现已经形成解决处理电磁学（包括半导体、等离子体、光学）、力学与传热分析、计算流体力学、以及化工、电化学反应（包括电池、燃料电池）应四大类问题的能力，外加一系列辅助功能模块（包括2500多种材料的物性数据）。

此次中仿科技的工程师来我所将就COMSOL多物理场仿真计算在科研中应用与各位研究人员进行交流，欢迎各位老师和同学参加！

活动安排：

- 1、COMSOL Multiphysics软件仿真思路以及理论介绍
- 2、COMSOL Multiphysics V4.3b新版本安装体验
- 3、互动问题交流

请发送您的信息（姓名、院系、联系电话）至 邮箱 cheney@cntech.com.cn 获取最新版软件，会议现场可自带电脑进行安装与使用体验。